

業界最高クラスの
ガラス転移温度 160°C

25mm角以上の
PKGに対応可能

ロングポットライフ
3日間

用途
半導体パッケージ/オートモーティブ

半導体パッケージや電子部品の実装補強、車載カメラモジュール、ミリ波レーダモジュール、車載ECU

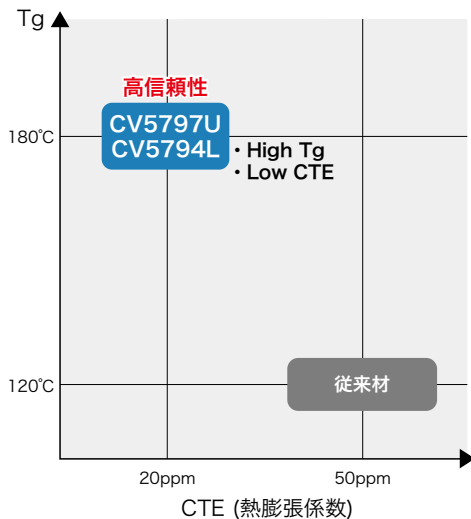
LEXCM^{DF}

CV5797 series CV5794 series

高耐熱性二次実装サイドフィル・アンダーフィル材

業界最高クラスのガラス転移温度と低熱膨張係数を両立し、車載に求められる実装信頼性を実現します。
「コーナー補強タイプ」もラインアップ。RoHS 対応。

コンセプト



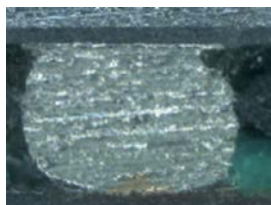
補強タイプ(適応半導体パッケージ)

サイドフィル		アンダーフィル
<p>大型 BGA など 10mm□~ 25mm□以上も対応</p> <p>BGA</p> <p>Motherboard</p>	<p>QFN</p> <p>QFN</p> <p>Motherboard</p>	<p>中・小型 BGA 20mm□以下</p> <p>BGA</p> <p>Motherboard</p>

車載環境下での温度サイクル試験に対応

CV5797U/ CV5794L

従来材



項目	CV5797U	従来材
温度サイクル試験 (TCT) -55°C⇔125°C 30分	6000サイクル パス	3000サイクル パス

一般特性

項目	単位	CV5797U サイドフィル (Corner glue)	CV5794L アンダーフィル
ガラス転移温度 (Tg)	°C	160	160
熱膨張係数 (CTE 1)	ppm/°C	13	21
曲げ弾性率 (25°C)	GPa	20	15
保管条件	-	-20°C/ 6ヶ月	

商品のご採用にあたっては、当社webサイトより注意事項をご確認ください。

上記データは当社測定による代表値であり、保証値ではありません。

industrial.panasonic.com/jp/electronic-materials

パナソニック インダストリー株式会社 電子材料事業部

Panasonic Industry CV5797